

# 2022年3月期 通期決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2022年6月

今を見つめなおし  
人と社会を一步先へ

1. 事業概要・特長
2. 2022年3月期決算の概要
3. 2023年3月期業績予想の概要と施策

1. 事業概要・特長
2. 2022年3月期決算の概要
3. 2023年3月期業績予想の概要と施策

商号 **株式会社シキノハイテック**  
Shikino High-Tech Co., Ltd.

本店所在地 富山県魚津市吉島829番地

代表者 代表取締役社長 浜田 満広

設立年月 1975年1月

資本金 420百万円

発行済株式数 4,415,000株

決算期 3月末

事業内容 電子システム事業・・・・・・・・・・半導体検査・装置関連  
マイクロエレクトロニクス事業・・LSI設計（アナログ・デジタル）、IP開発  
製品開発事業・・・・・・・・・・画像関連機器、CMOSカメラモジュール

従業員数 369名（2022年4月1日時点）

国内拠点 魚津工場、東京デザインセンター、大阪デザインセンター、福岡デザインセンター  
九州事業所

## 社是

和して拓く

## 社訓

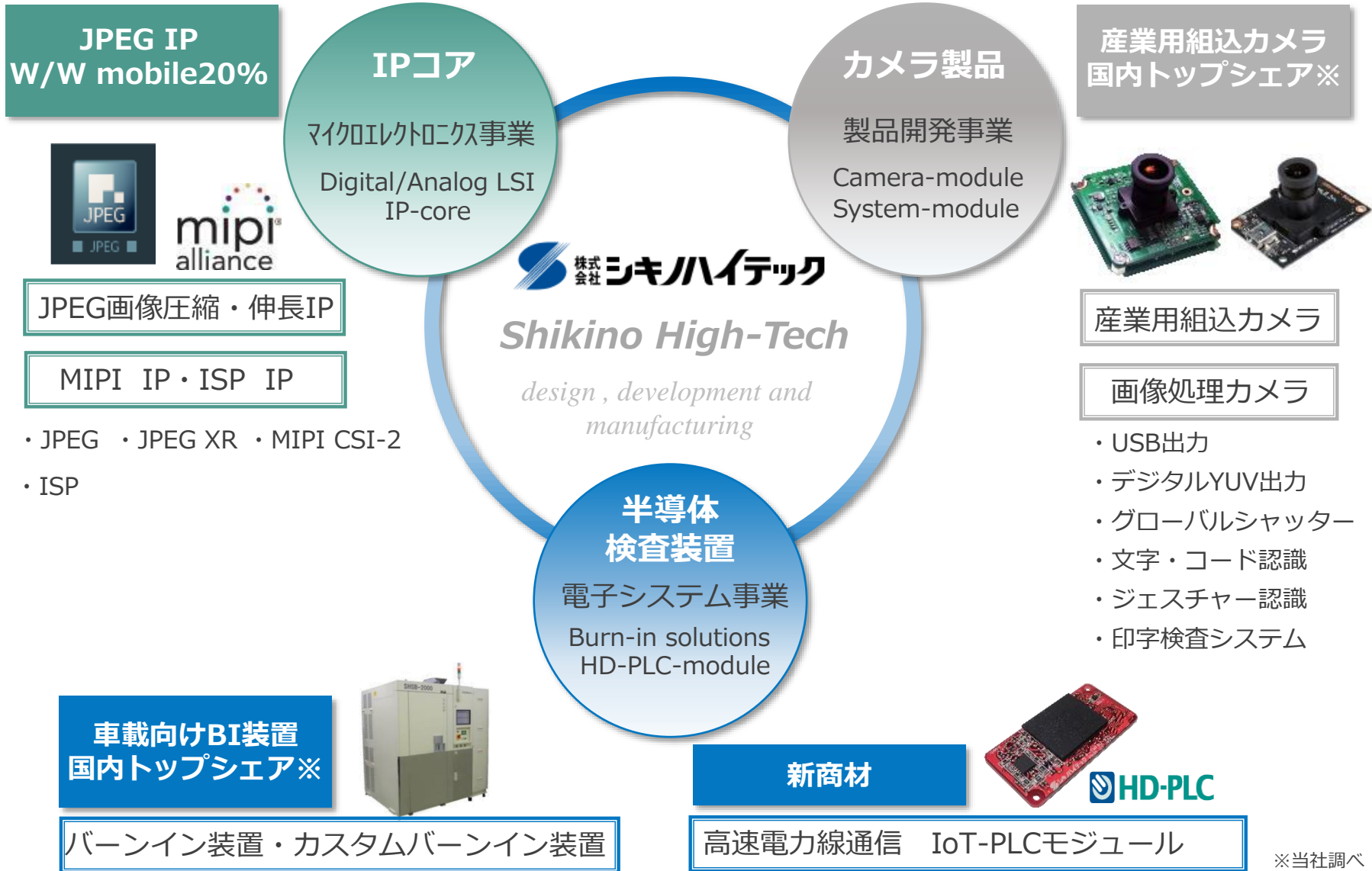
社業を通じ社会に奉仕

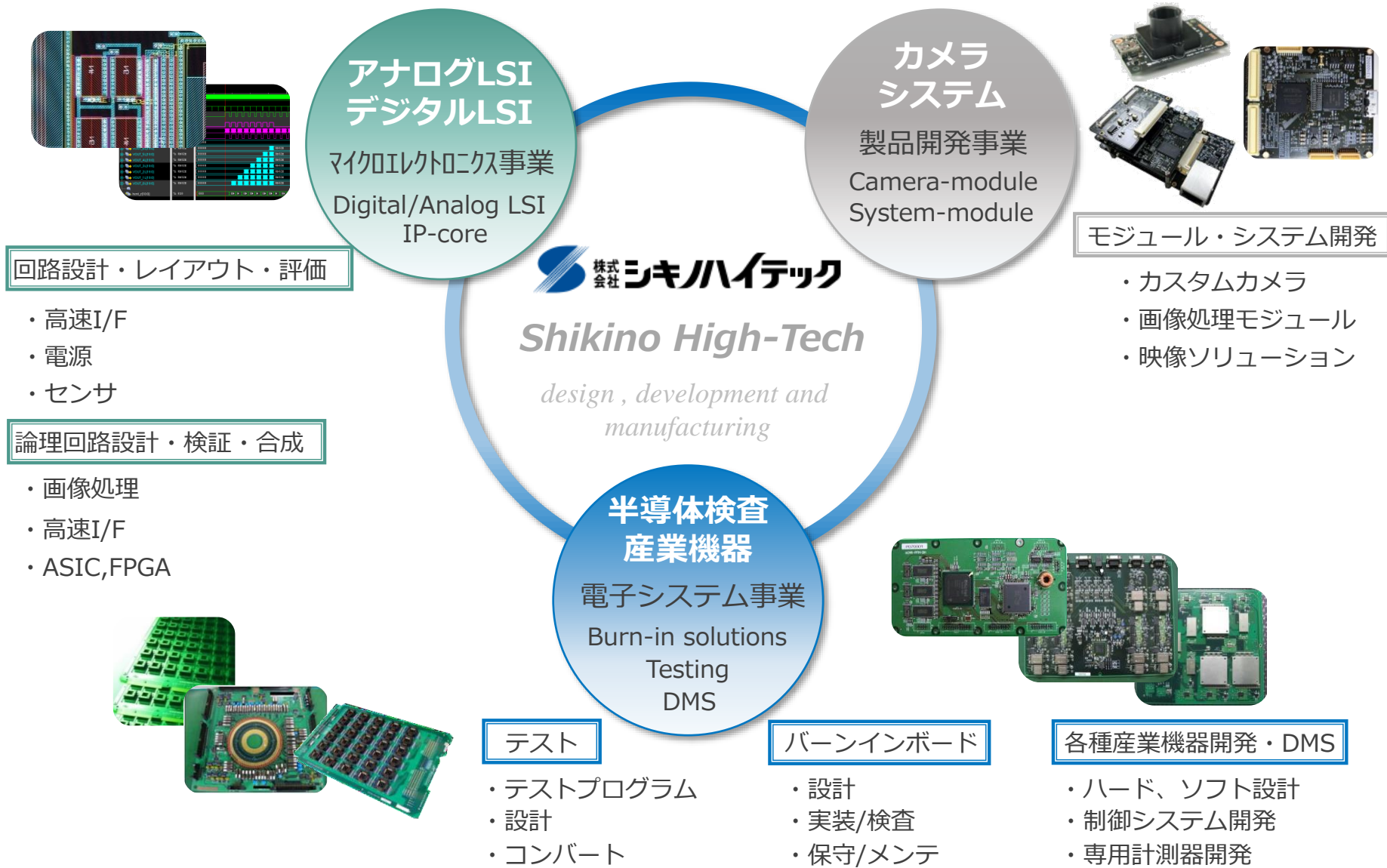
企業の永續と繁栄

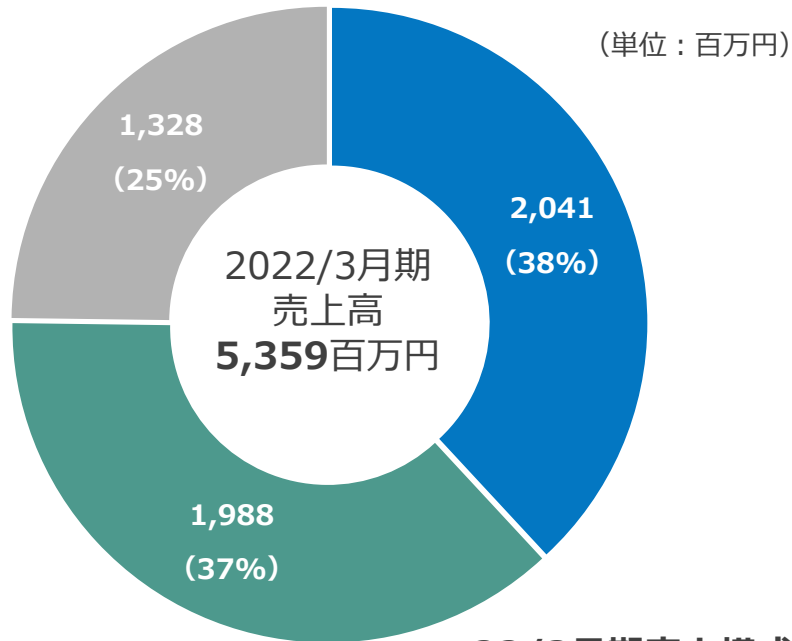
社員の幸福と人格の向上

## 経営理念

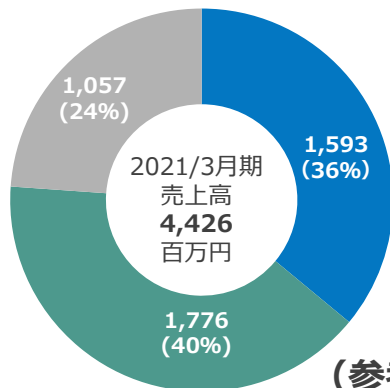
我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを創り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します。







22/3月期売上構成



(参考) 21/3月期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、各種専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

## 製品開発事業

### 製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

特長のある3つの事業・技術（各種強いアイテムを保有）をコアに、新しい分野に展開

事業環境上のリスク分散が効く事業ポートフォリオ

各事業が保有する技術での事業間シナジーを創出

育成に長期間を要する高度アナログ技術を保有

AI技術進化でISP応用分野が拡大する画像製品

車載EV化の進展により半導体検査が求められる製品領域拡大

**アナログLSI  
デジタルLSI**

マイクロエレクトロニクス事業  
Digital/Analog LSI  
IP-core

**カメラ  
システム**

製品開発事業  
Camera-module  
System-module

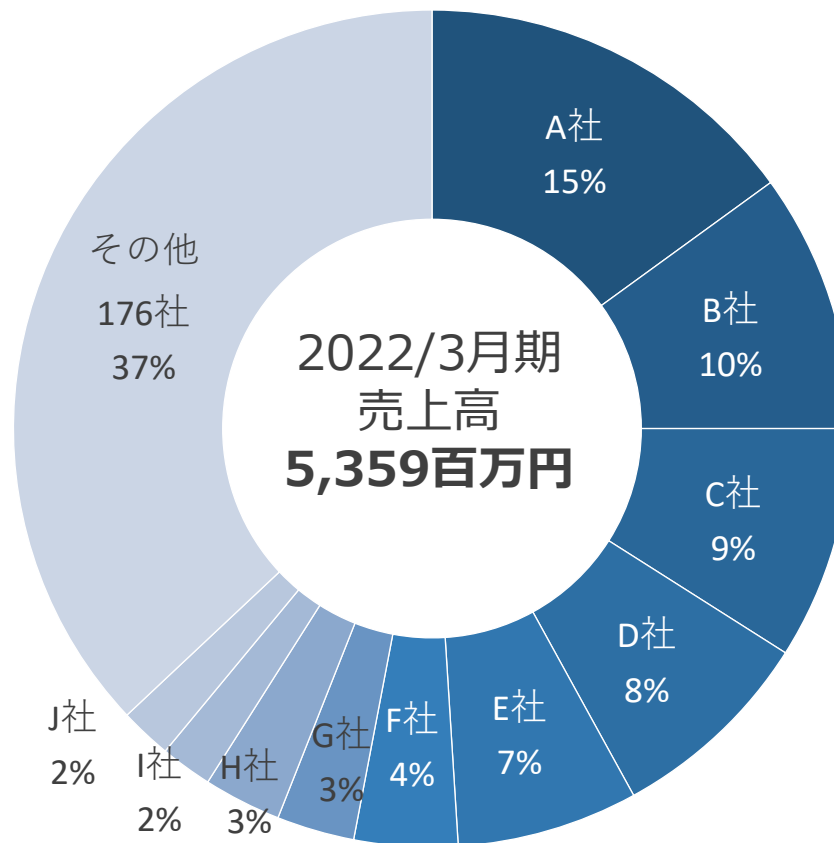
**半導体検査  
産業機器**

電子システム事業  
Burn-in solutions  
Testing  
EMS

車載・5Gクラウドサーバー向けの引き合いが旺盛



主要顧客との安定的な取引と販売先の分散が図られた強固な顧客基盤



1. 事業概要・特長
2. 2022年3月期決算の概要
3. 2023年3月期業績予想の概要と施策

売上高は前期比21.1%増収、経常利益は99.2%増益、当期利益は189.1%増益で着地

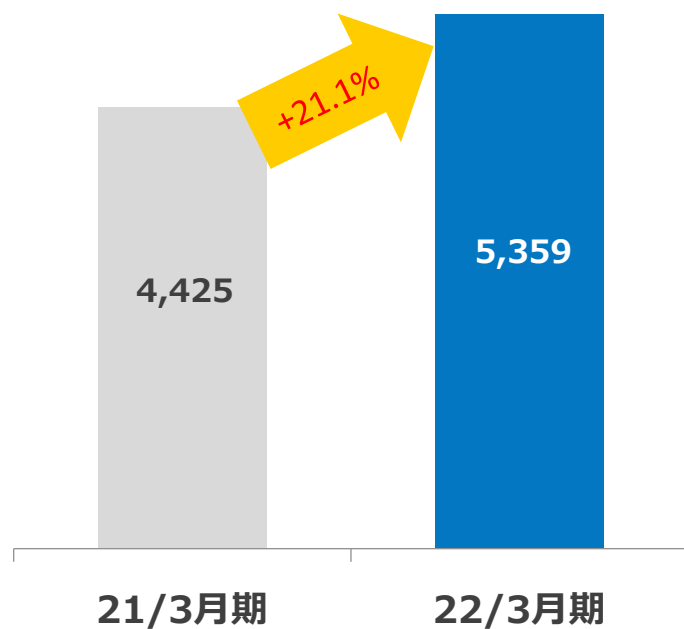
- 売上高は、新型コロナウイルスの影響等を受けたが、受注は活発で21.1%の増収
- 経常利益は、高付加価値製品への取り組み、コスト削減の取り組みを行ったことにより、売上増加に伴って経常利益で99.2%の大幅な増益

(単位：百万円、%)

科目	2021/3月期 実績		2022/3月期 実績		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	増減率
売上高	4,425	100	<b>5,359</b>	<b>100</b>	933	21.1
営業利益	203	4.6	<b>396</b>	<b>7.4</b>	193	95.1
経常利益	209	4.7	<b>416</b>	<b>7.8</b>	207	99.2
当期純利益	113	2.6	<b>327</b>	<b>6.1</b>	214	189.1

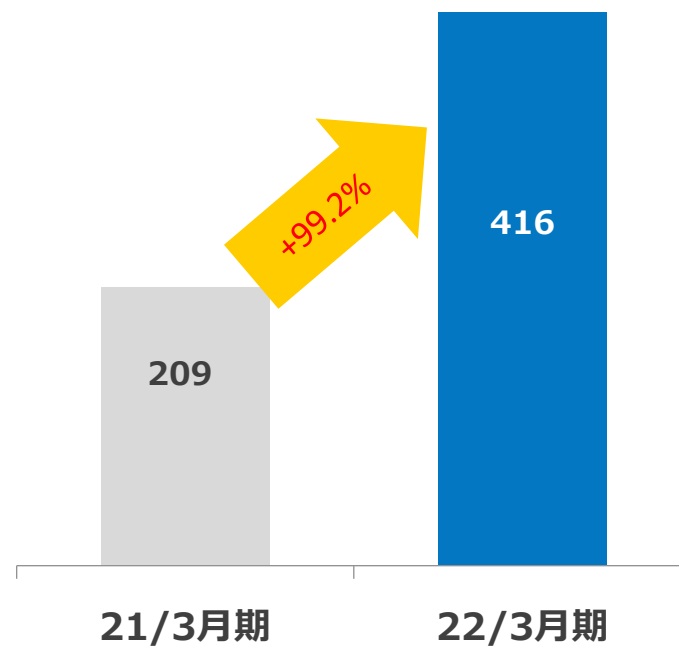
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

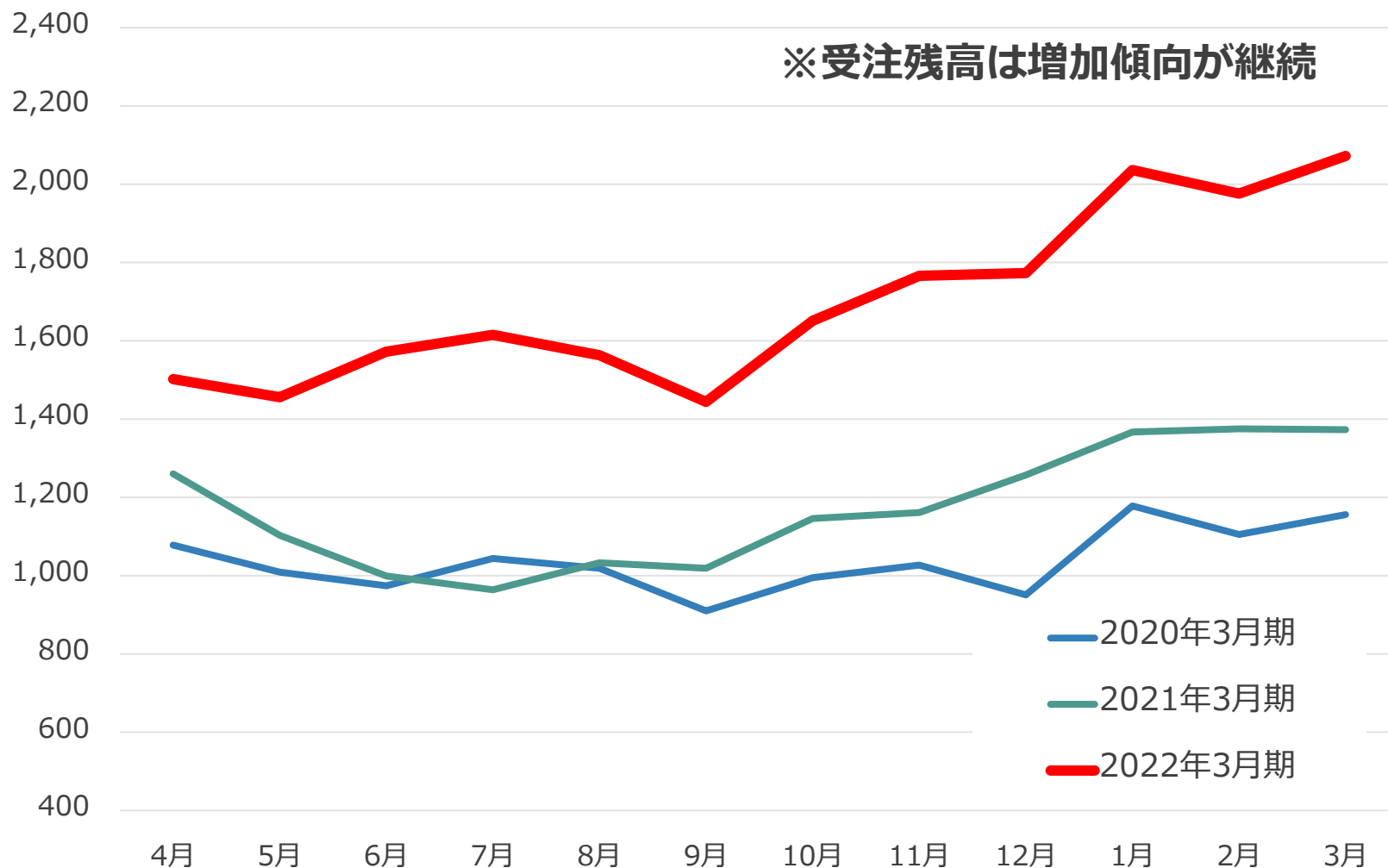
(単位：百万円)



※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

## 【受注残高（全社）】

(単位：百万円)



## 電子システム事業

- 半導体主要顧客の生産増加に対する検査装置の販売/レンタル、バーンインボードの販売が好調
- 各種産業機器顧客向け専用計測器の新規先、既存先への拡販
- 高速電力線通信モジュールの市場投入開始

⇒売上高：前期比：+28.2%

セグメント経常利益：164百万円

(前期比：+172百万円)

## マイクロエレクトロニクス事業

- 画像処理半導体のデジタル設計受託やJPEG IPの販売が好調
- アナログ設計受託の注力分野を高速インターフェース、センサ、電源分野に加え、メモリ分野にも拡大

⇒売上高：前期比：+12.0%

セグメント経常利益：272百万円

(前期比：+34百万円)

## 製品開発事業

- ビューカメラ、センシングカメラの新規先・既存先へ拡販、マイナンバーカード応用機器向けが好調
- 医療・介護向けカメラシステムの開発に着手

⇒売上高：前期比：+25.7%

セグメント経常利益：△19百万円

(前期比：+0.5百万円)

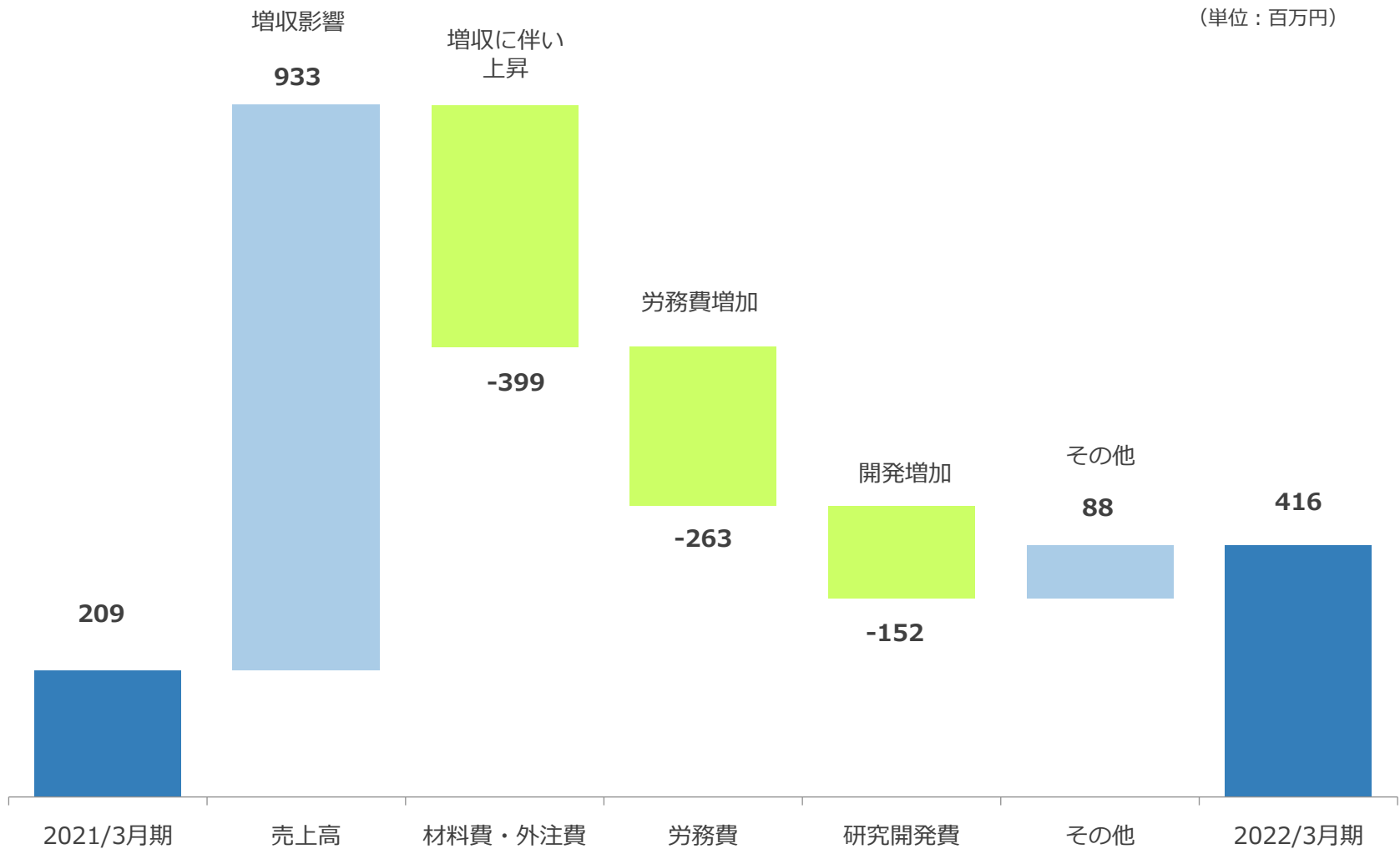
※セグメント経常利益：当社内で管理している経常利益ベースでセグメント利益を表しています。

# 経常利益増減要因（決算概要）

増益要因

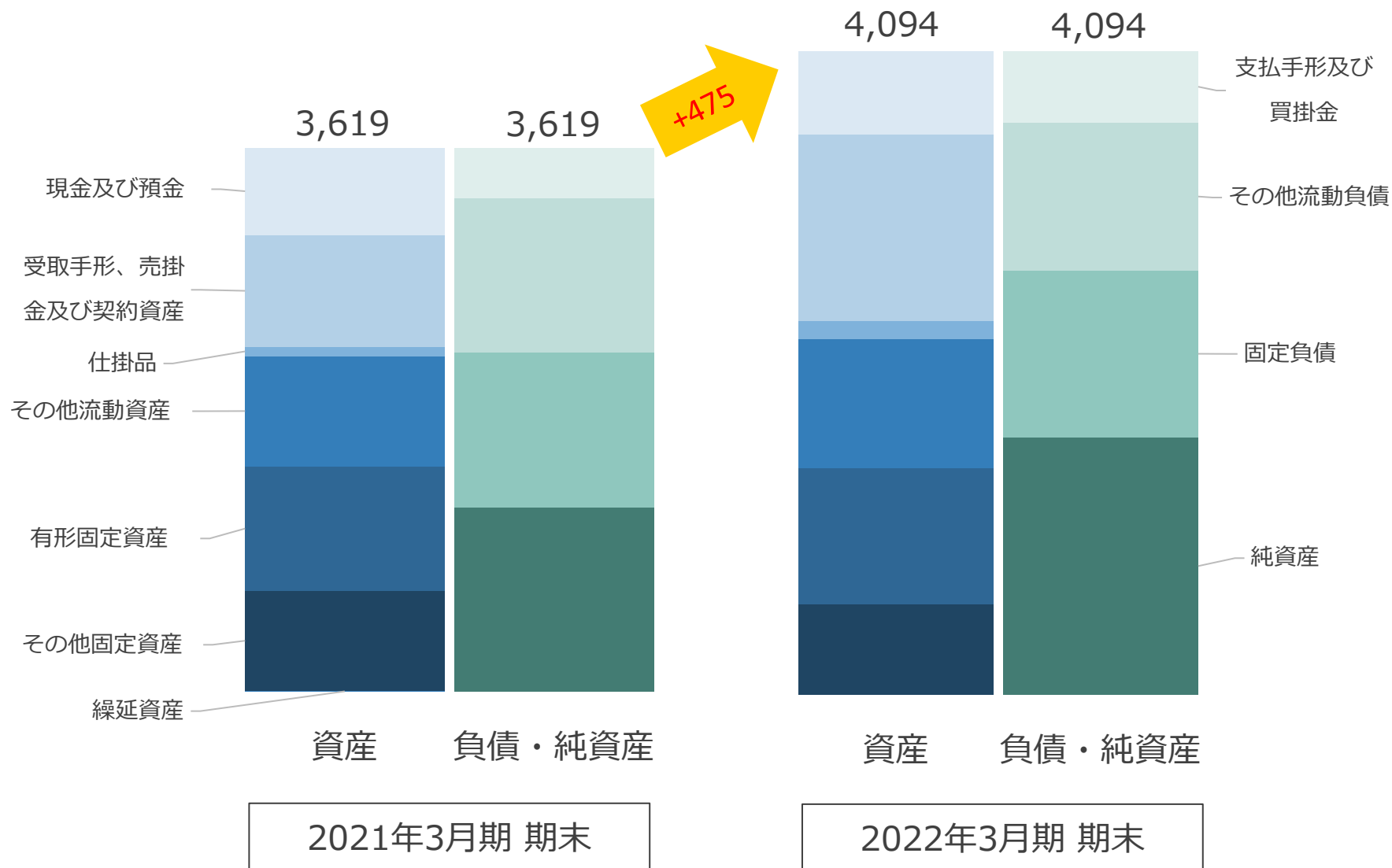
減益要因

(単位：百万円)



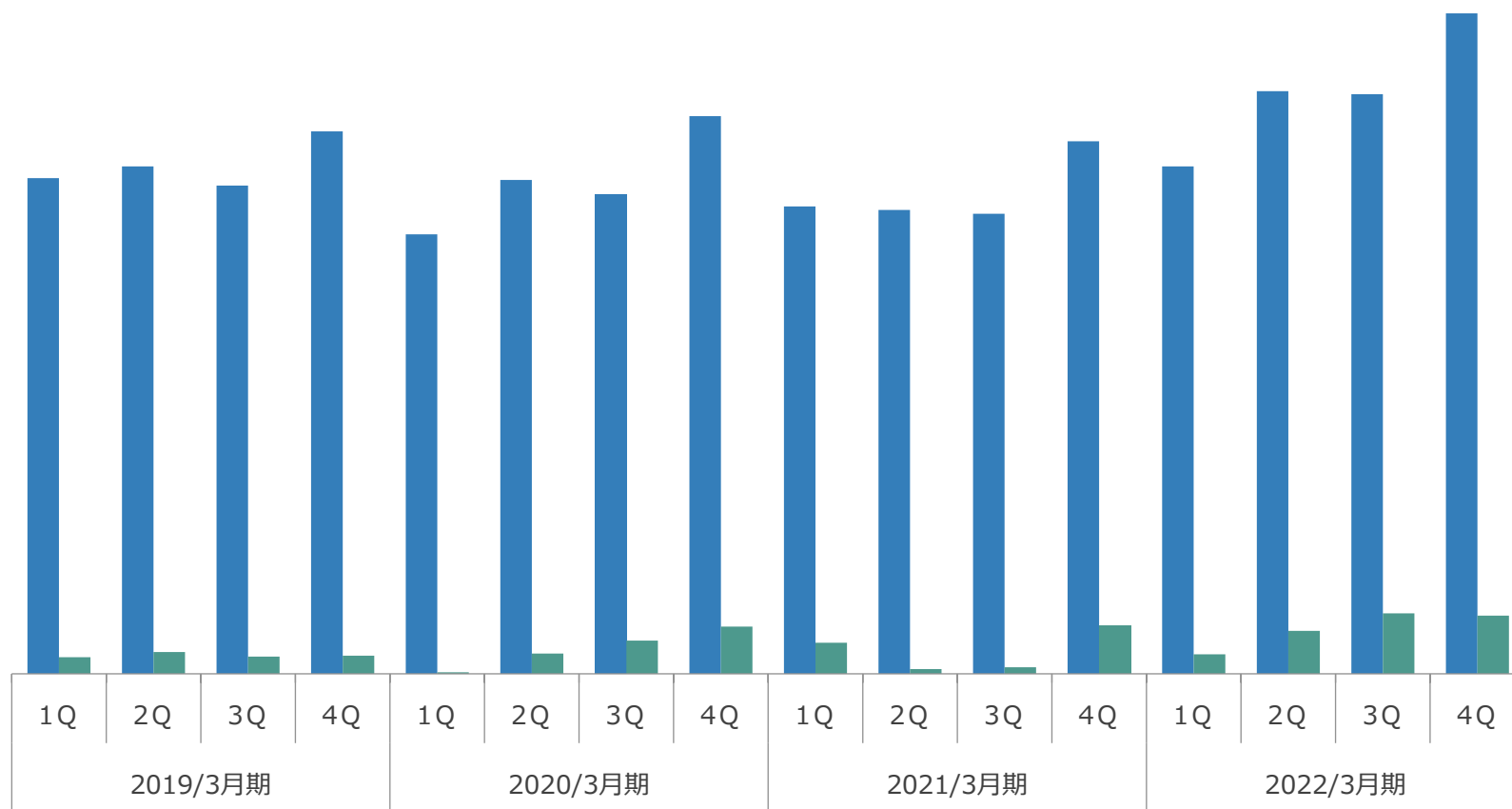
# 貸借対照表

(単位：百万円)





■ 売上高 ■ 経常利益

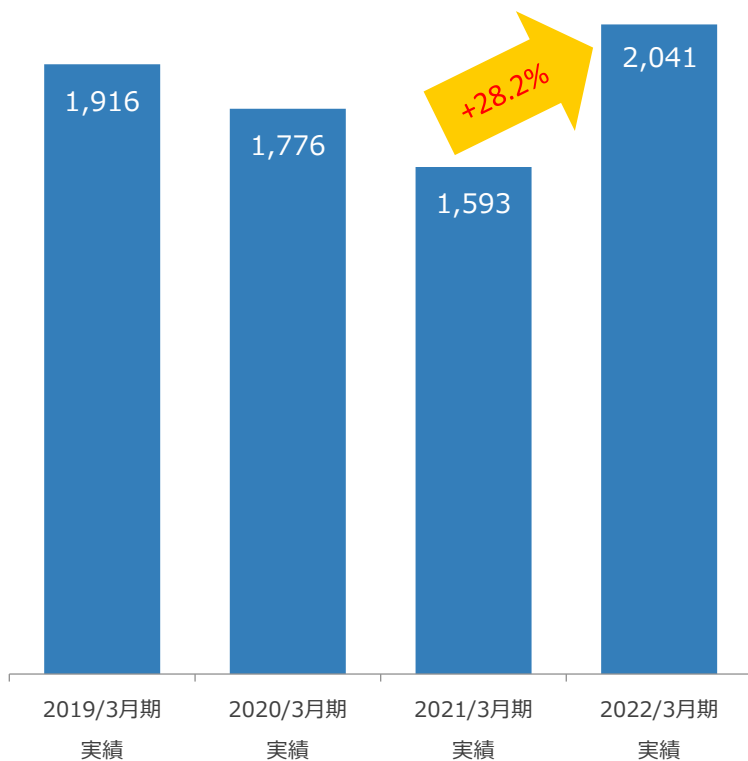


※経常利益の季節傾向を明確にするため、経常利益のスケールを調整しています。

半導体生産設備投資の回復により半導体後工程商材の需要増、車載製品用専用計測機器関連の受注増により、前年比売上増。新商材のIoT-PLC製品を市場投入後、引合い増加中。

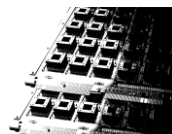
【売上高】

(単位：百万円)



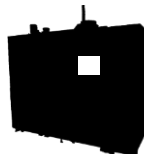
## 21年度 トピックス

➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注増



バーンインボード

前年比：174%



半導体検査装置販売・リース

前年比：189%



車載製品用専用計測機器関連

前年比：112%

スマートビルディング EXPO 2021 出展



2月 九州事業所拡張

1月 ねぷコンJAPAN2022 出展

12月

7月

高速電力線通信推進協議会加入

P-TMFSU-H31

6月

陸通型式取得

HD-PLC

4月

HD-PLCアライアンス一般会員加入

新商材

4月

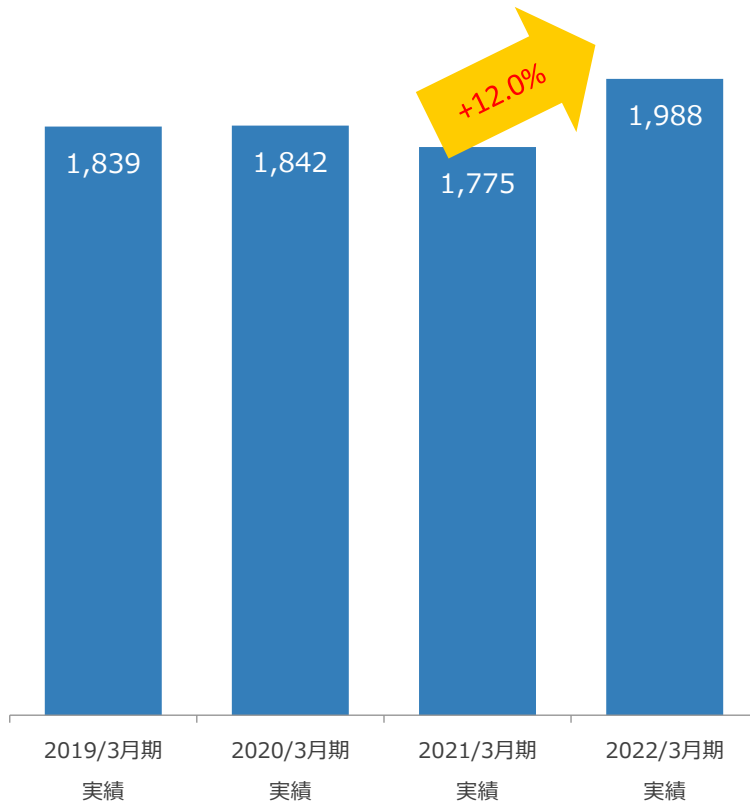
IoT-PLC取り扱い開始・サンプル出荷



旺盛な半導体需要に支えられ、アナログはセンサー半導体、パワー半導体、デジタルは画像処理半導体の設計需要が堅調に推移、既存IP需要増加に加え、新たに画像処理IPも開発。

## 【売上高】

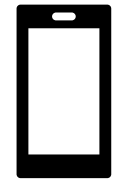
(単位：百万円)



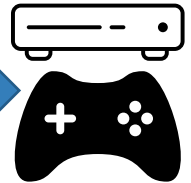
## 21年度トピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

スマートフォン向けセンサ関連  
アナログ設計受託  
前年比：120%



汎用商品向けパワー半導体関連  
アナログ設計受託  
新規受注

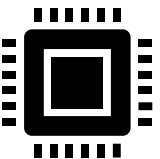


### ➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連  
デジタル設計受託  
前年比：207%



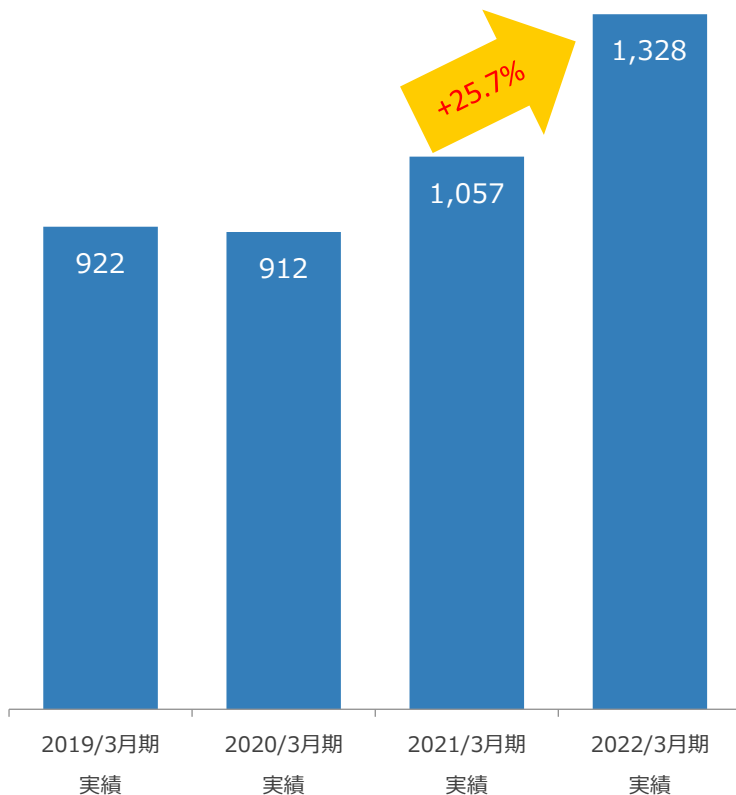
JPEG-IP 前年比：120%  
画像信号処理IPも新規開発



車載・産業機器市況の回復基調継続に伴うカメラ需要増加、動画伝送機能搭載カスタムカメラ、マイナンバーカード応用機器等の出荷増加等により前年より販売が大幅に増加。

## 【売上高】

(単位：百万円)



## 21年度 トピックス

DX市場向け「画像センシング用カメラ」をエッジからクラウドまでラインナップ

エッジ画像処理		エッジAI用		クラウド画像処理用	
	NEW SW開発キット インテリジェントカメラシリーズ (スマートカメラ)		NEW AI用カメラ KBCR-S08MM AI用カメラ		NEW 顔認証用カメラ KBCR-S03TUA 顔認証用カメラ
					開発中 LAN出力カメラ KBCR-ic21MG LAN出力カメラ

1月: ネプコンJAPAN2022出展

12月: 国際画像機器展2021出展

10月: エッジAI用 130万画素MIPIカメラリリース

9月: 「チップワンストップ」で オンライン販売を開始

8月: 富山県ヘルスケア産業育成創出事業採択

4月: 200万画素USBカメラ2機種リリース

新製品: KBCR-S08MM

新製品: KBCR-S03TUA, S03TU

半導体事業における増産に対応するため、  
人員増強を図っております。

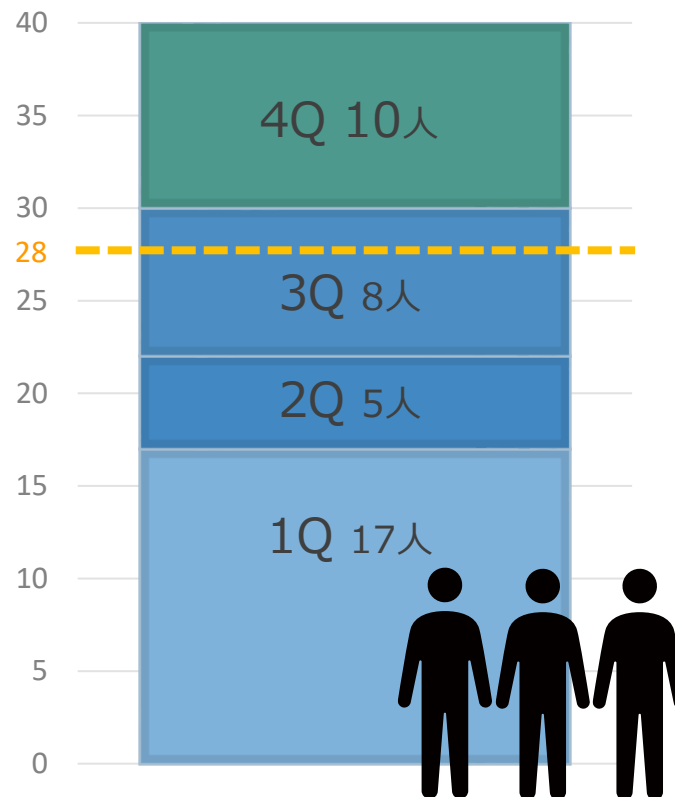
また、同期間中に退職者が発生したこと  
に伴い、採用枠を増加。

通期で28人の採用計画に対し、40人の  
採用となりました。

人員

通期採用計画：28人

実績率  
142.9%



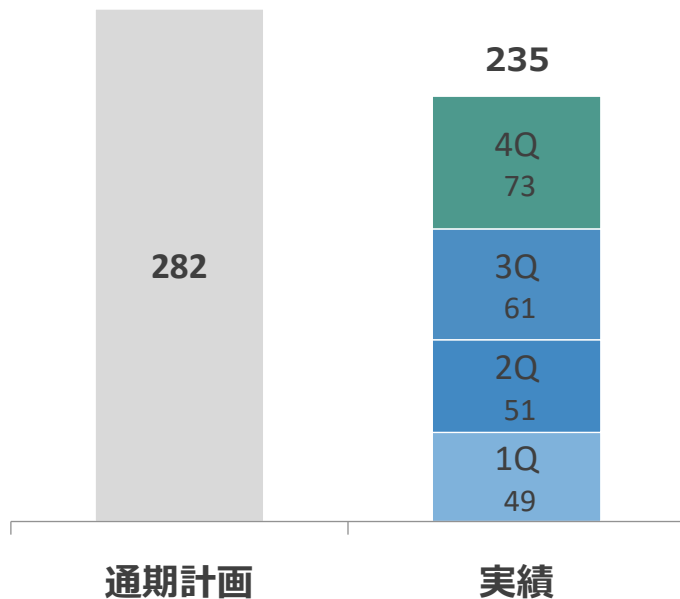
# 今期計画に対する実績【研究開発費】

研究開発に投下している「工数」は順調に進捗しています。

研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

## 【研究開発費】

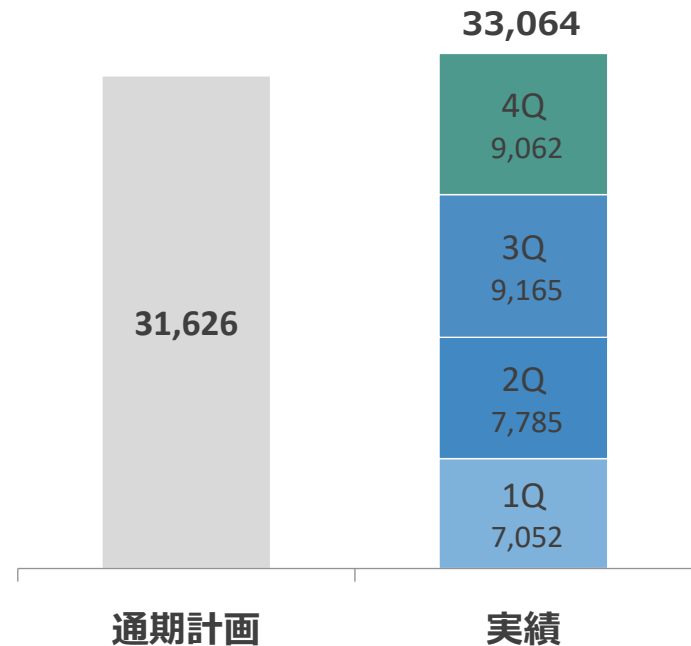
(単位：百万円)



実績率 83.7%

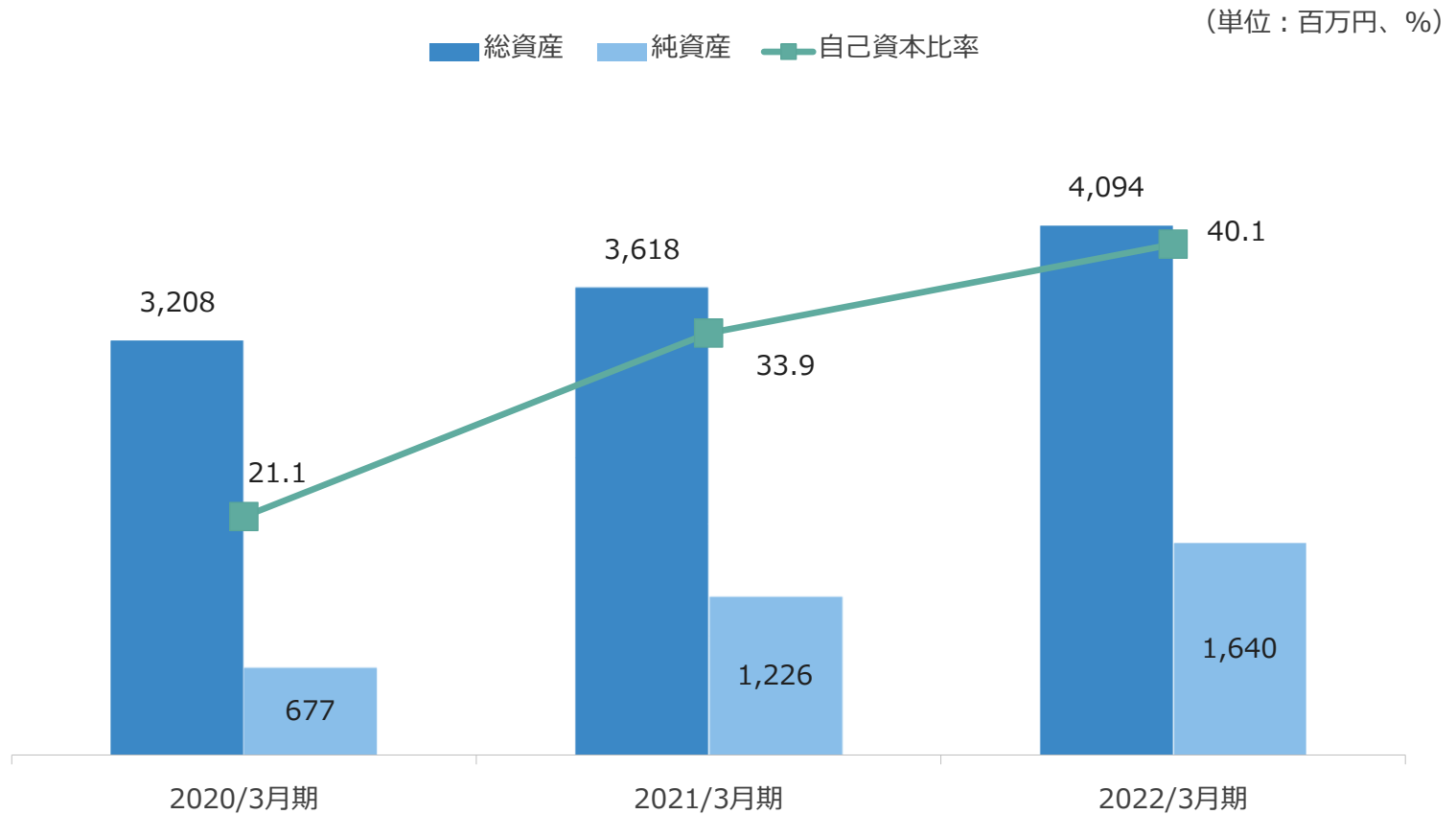
## 【研究開発工数】

(単位：H)



実績率 104.5%

## 自己資本比率は上昇基調で推移



1. 事業概要・特長
2. 2022年3月期決算の概要
3. 2023年3月期業績予想の概要と施策



各事業でコア事業の集中・安定化と新規成長事業へ取り組み、継続的成長を実現

## ①中核事業の競争力強化

電子システム事業 . . . . . 検査機器の単品販売からソリューションへ展開（スクリーニング、各種専用計測）

マイクロエレクトロニクス事業 . . . アナログを強化し新分野への展開、デジタルをソフトウェアで強化

製品開発事業 . . . . . 医療関連機器・産業機器への事業領域拡大による販売拡大

## ②新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

電子システム事業 . . . . . 新機能付きバーンイン装置の開発

マイクロエレクトロニクス事業 . . . JPEGやISPのIP機能進化と自社デバイスの開発

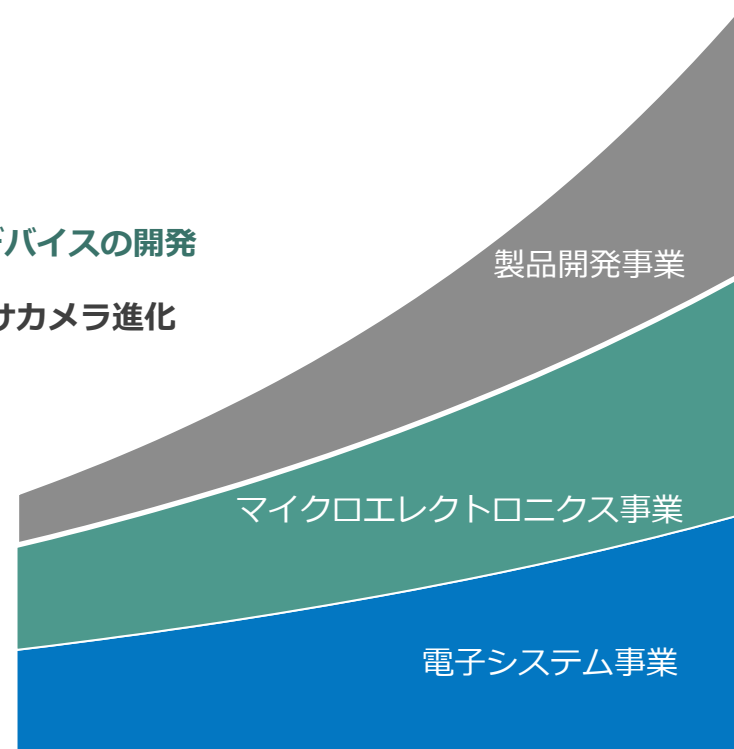
製品開発事業 . . . . . 3D・AI技術導入しセンシング向けカメラ進化

## ③新市場、グローバル戦略の拡大

電子システム事業 . . . . . OSATを足掛かりにした海外展開

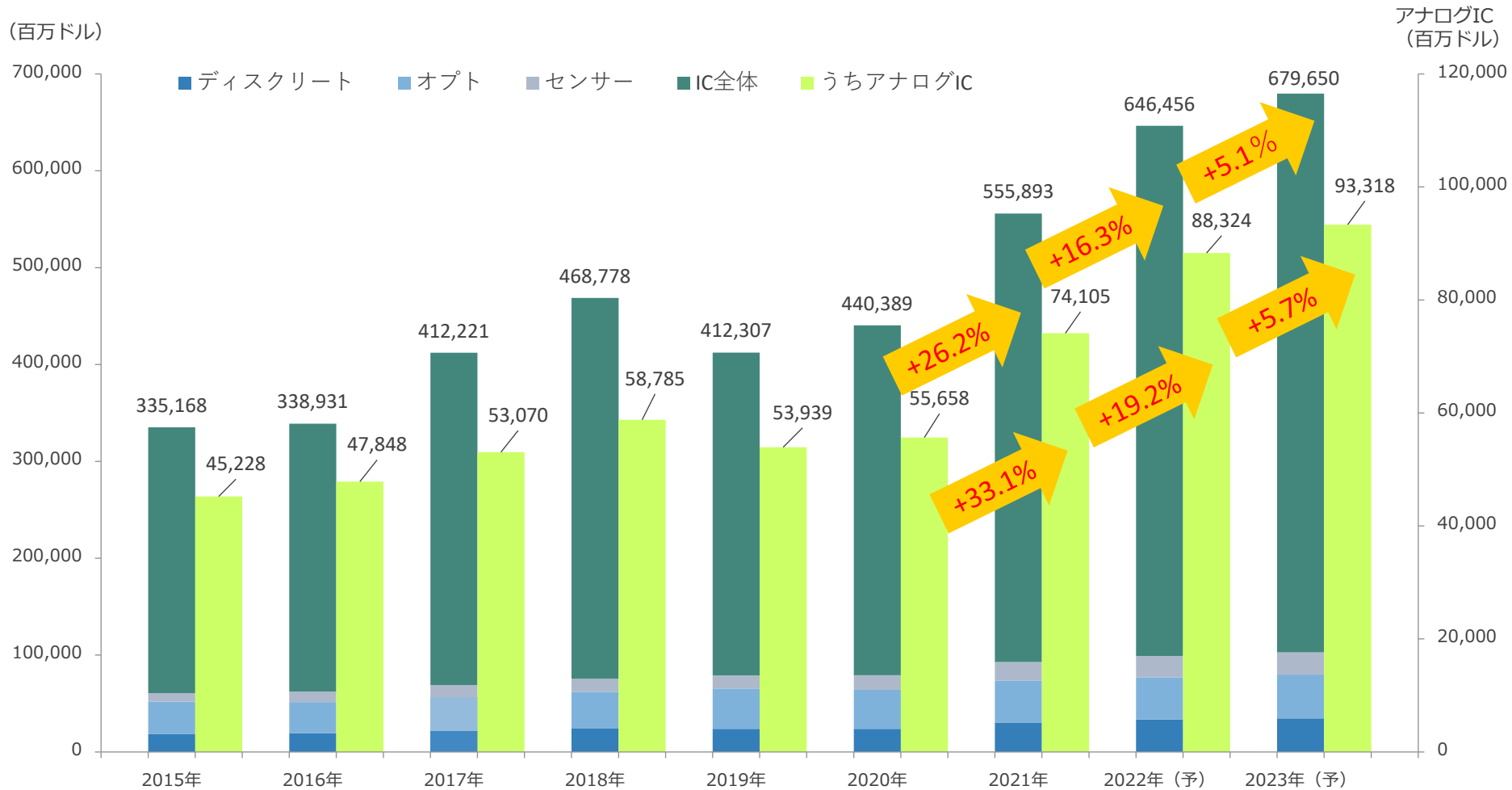
マイクロエレクトロニクス事業 . . . IP販売のグローバル展開

製品開発事業 . . . . . 画像応用製品での事業化推進



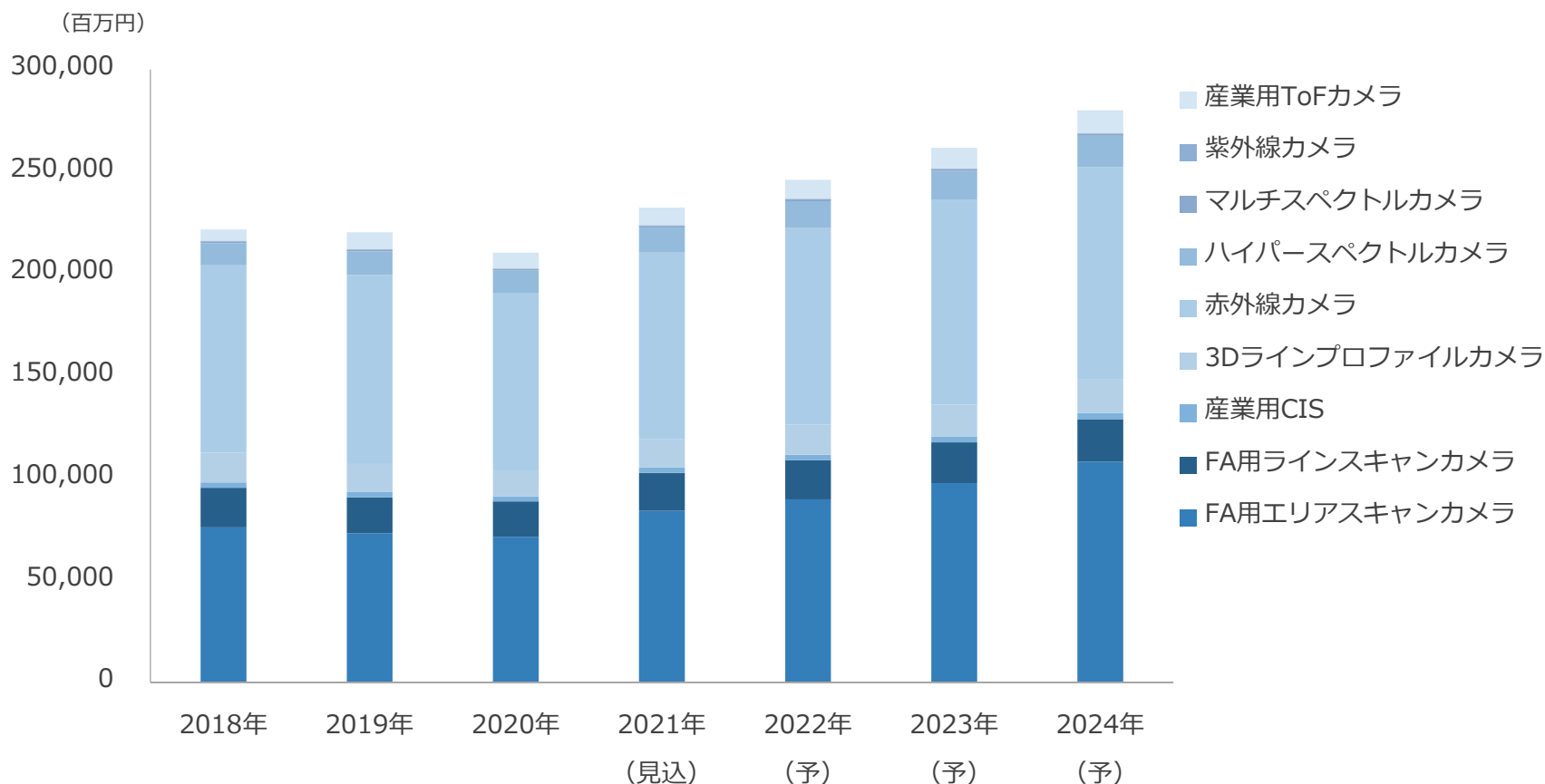
# 半導体市場の動向

世界半導体市場は新型コロナ影響での、パソコン・タブレット・5G関連・データセンター関連機器等の半導体をけん引した要因が継続し、2022年は16.3%と2桁成長を予測  
2023年は穏やかながら継続して成長を予測。アナログICでは半導体全体以上の伸びを予測。



# カメラ市場の動向 (W/W)

2020年後半からコロナ影響が回復、半導体関連の部品不足が顕在化しているものの、製造業を中心とした自動化が促進、市場は堅調に伸びると予測される。カメラ市場では、2024年度にかけ毎年+6~7%の成長が見込まれている。



出所：株式会社富士経済「2022画像処理システム市場の現状と将来展望」より当社作成

# 2023年3月期業績予想

- 顧客ニーズを的確に捉え、生産性のより一層の向上と機動力を発揮して取り組みます。
- 新製品・新技術の開発に積極的に先行投資するため、売上増加率7.6%に対し、  
経常利益増加率は4.0%となります。

(単位：百万円)

	2022年3月期	2023年3月期		
	実績	見通し	増減額	増減率
売上高	5,359	5,765	405	7.6%
営業利益	396	410	13	3.5%
経常利益	416	433	16	4.0%
当期純利益	327	337	10	3.2%
研究開発費	235	267	31	13.5%

# 各セグメントの状況

## ●半導体関連

市場は継続して拡大 (WSTS '22/6)

'22年度 16.3%の成長、アナログIC：19.2% センサー：15.7%

- 世界的な「半導体不足」はまだ続く。各社とも製造設備への投資活動は続伸
- 車の電子化加速により車載機器も継続して成長、製造設備への投資活動も続伸
- カメラ搭載機器を含むIoT機器は継続し市場成長。'22年度106%成長 (富士経済 '21/12)

### 電子システム事業

- 車載半導体生産能力向上に伴う検査装置/ボードの需要拡大が継続
- センサー、光、パワーデバイス等新規デバイスに対する検査の導入
- BI検査の設備投資から装置レンタル、検査委託などニーズの多様化

### マイクロエレクトロニクス事業

- パワー半導体の市場は堅調に拡大  
国内の画像処理半導体の設計需要はASICからFPGAにシフト
- 半導体設計人材の争奪戦が激化
- JPEGとISPのIP機能・性能拡大とグローバル販売への取り組み推進

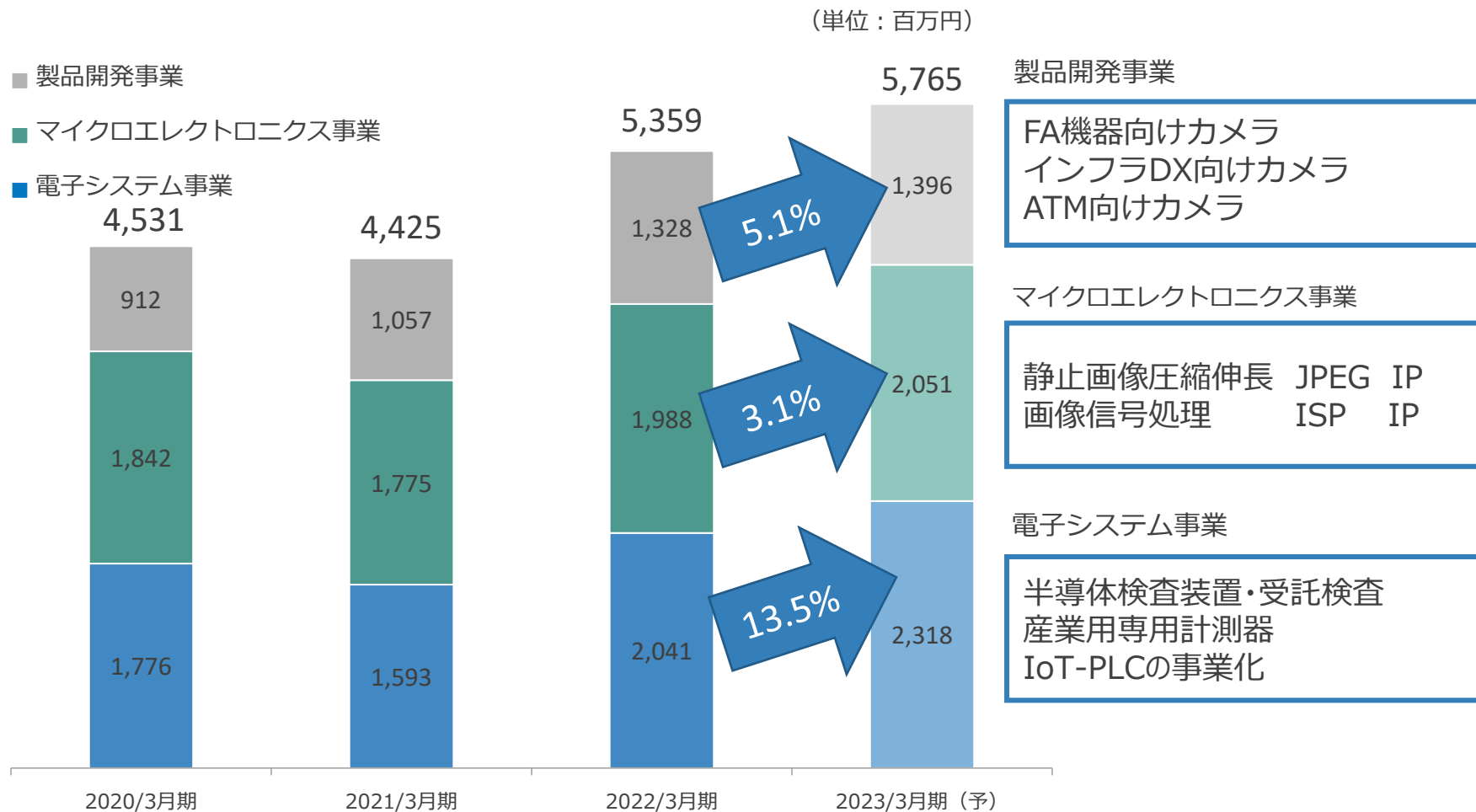
### 製品開発事業

- 国のDX推進によるインフラ市場の需要が回復
- センサとしてのカメラ用途が認識/認証・自動化用途で拡大
- 3Dセンシング技術の強化と医療介護分野での完成品取組み

(単位：百万円)

	2022年3月期		2023年3月期	
	実績	予想	増減額	増減率
電子システム事業	2,041	2,318	276	13.5%
マイクロエレクトロニクス事業	1,988	2,051	62	3.1%
製品開発事業	1,328	1,396	67	5.1%

2023/3期は、継続する半導体需要増加により電子システム、マイクロエレクトロニクス事業は増収を予想。製品開発事業はコロナからの回復によりインフラ、設備投資が回復しカメラ需要の増大に伴い増収を予測



売上高	:	5,765百万円	(対前年 7.6%)
営業利益	:	410百万円	(対前年 3.5%)
経常利益	:	433百万円	(対前年 4.0%)

## 2022年度経営方針：成長戦略の実行加速と強化

### ◆各事業での成長戦略を実行加速

- ・中核事業の競争力強化
- ・新技術・新製品の創出早期化、事業化推進
- ・新市場、グローバル戦略の拡大

### ◆事業成長に向けた事業基盤の強化

- ・社内DX化に向けたインフラ投資完遂・基幹システム構築。23年度より運用開始
- ・新規事業領域への拡張に向けた品質システムを強化
- ・事業拠点の新設・拡充

- 温度制御技術の強みを活かしBI事業のソリューション展開で拡大
- 重点顧客専用計測の高シェアを維持し、IoT-PLCで新たな売りを作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ BI事業モデルをソリューションに拡張、お客様の多様な要望に応える
  - ・ 機器レンタル、受託検査、信頼性検査、メンテナンス等サービス領域を拡充
  - ・ サービス/生産能力向上のための拠点強化（熊本事業所開設、本社工場拡張）
- ◆ 重点顧客向け車載機器専用検査装置のバリエーションを拡大
  - ・ 機能に応じた専用検査機能の拡充

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ 車のCASE進展に伴うBI装置の技術進化
  - ・ 多様なデバイスへの製品展開（微細プロセス、センサー、パワーデバイス）

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 新領域・グローバルでのビジネスにチャレンジ
  - ・ IoT PLC 第三世代量産開始と第四世代要素開発
  - ・ アジア系国内OSAT参入を足掛かりにグローバル展開への布石を打つ



- アナログ設計とFPGA+ソフトでエンジニアリング事業基盤を強化する
- IP商品の展開と自社ASICで新たな事業を作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ 顧客の水平展開・技術領域拡張しエンジニアリング事業を強化
  - ・ 電源分野を中心にアナログ設計受託を強化
  - ・ FPGA設計受託分野においてソフト設計受託で強化を検討

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

- ◆ IPの機能進化と自社デバイスの開発
  - ・ JPEGとISP-IPにおける機能、性能拡大の開発を推進
  - ・ アナログ、デジタル分野の自社デバイス開発検討を加速

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ IPのグローバル販売を強化
  - ・ 海外IPポータルサイトの更なる活用
  - ・ 海外市場でのIP販売拡大に向けた協業先の検討を加速

- ビューはインフラ・産業で顧客拡大、センシングは性能強化で用途拡大
- ビジョンソリューションは医療・AI応用に参入し新たな事業を作る

## 中核事業の競争力強化

- ◆ インフラ機器のDX化を視野にセンシング向け商品ラインナップを強化
  - ・ 微細な画像を識別可能な200万画素超の高画素カメラモジュール
  - ・ 応用シーンを広げる長距離伝送可能なIF搭載カメラモジュール

## 新技術・新製品の創出早期化、事業化推進

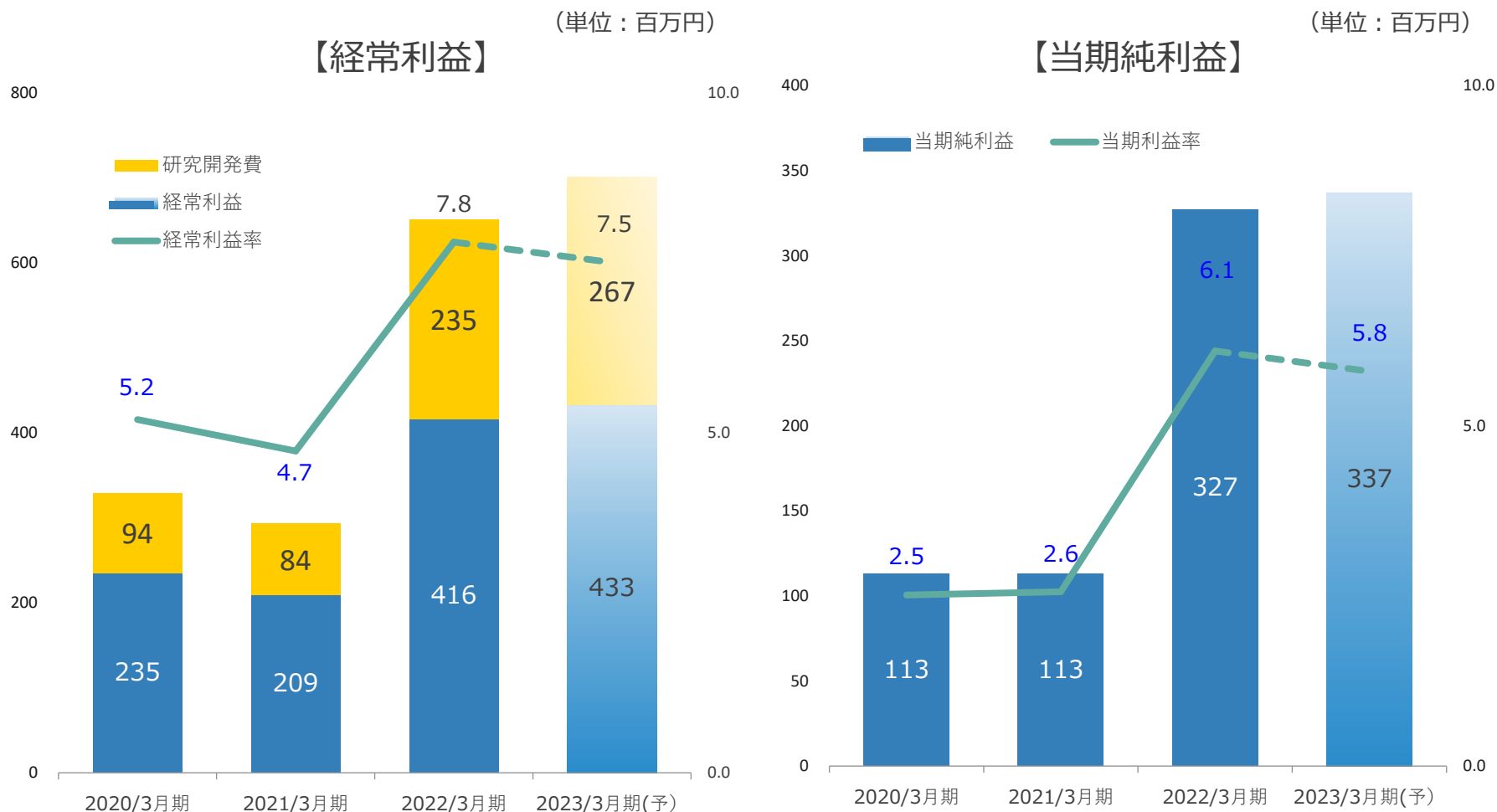
- ◆ AI画像処理に適した新製品開発の加速
  - ・ 外部技術の導入により高性能3Dカメラの開発を加速
  - ・ 画像処理LSI/CPUメーカーとの協業の検討

## 新市場、グローバル戦略の拡大

- ◆ 画像処理技術を活かした新領域でのビジネスにチャレンジ  
先行要素開発から製品開発フェーズへのシフトチェンジ
  - ・ 見守り介護システム（富山県ヘルスケア産業育成事業採択テーマ）
  - ・ 医療機器向け画像処理システム

# 経常利益・当期純利益の推移

2022/3期は活発な受注による増収影響や高付加価値製品の取組み、コスト削減で増益。  
2023/3期は、研究開発費を前期以上に投下する計画のため、増益率は緩やかになるが  
前期に引き続き増収増益を予想。

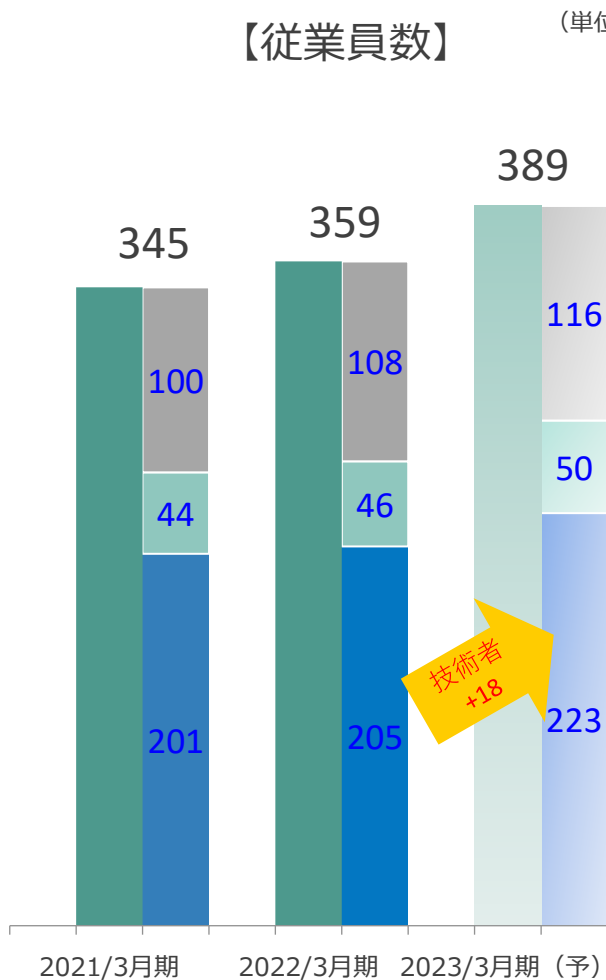


2023/3期は次年度以降の成長に向け、研究開発費の増額を計画するとともに、主にエンジニア・営業を中心に30名の人財を増強。

【従業員数】

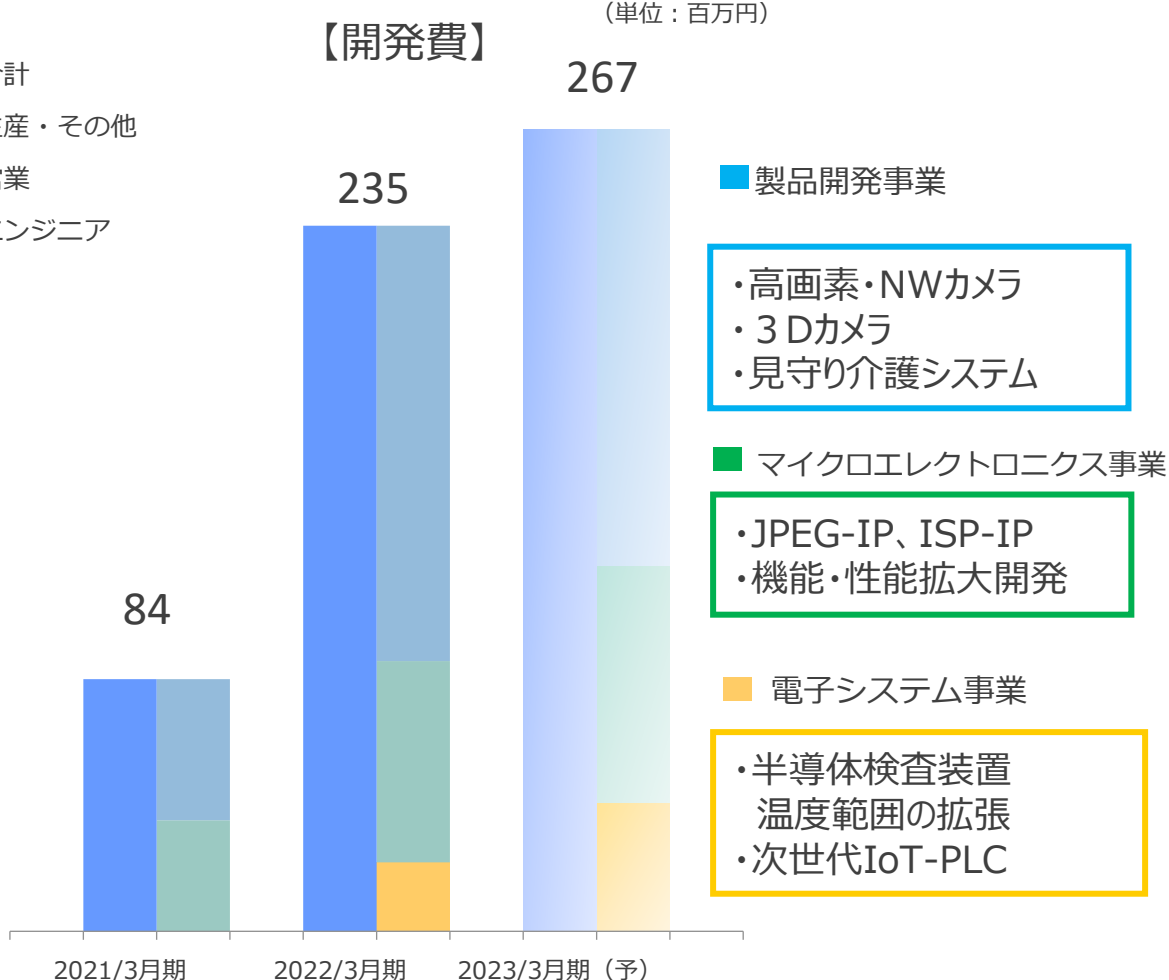
(単位：人)

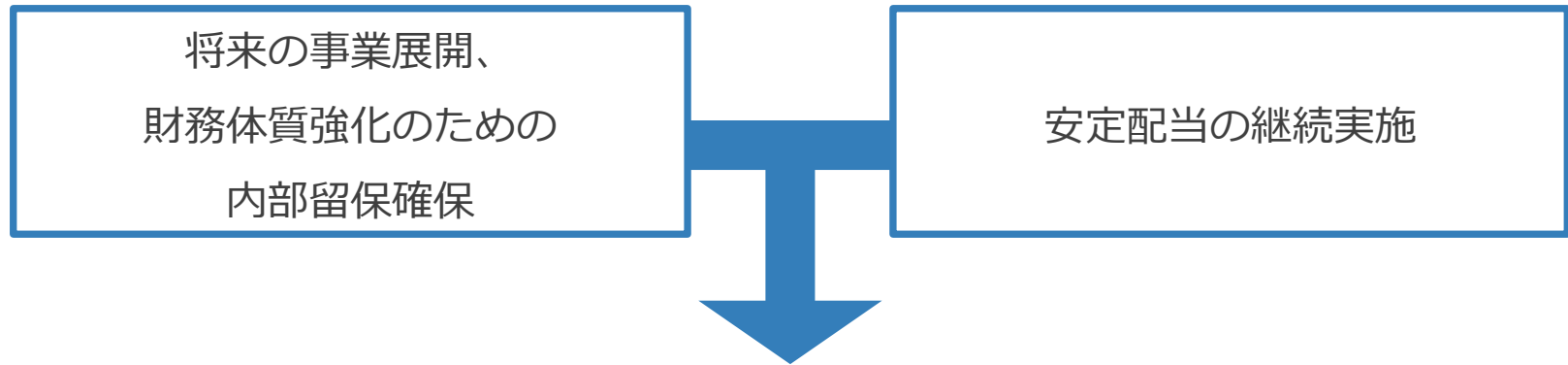
- 合計
- 生産・その他
- 営業
- エンジニア



【開発費】

(単位：百万円)





## 株主への利益還元も重視したバランス経営を推進

(単位：円)

	1株当たり当期純利益および配当金	
	2022年3月期実績	2023年3月期予想
1株当たり当期純利益	<b>75.35</b>	<b>76.54</b>
中間配当金	<b>0</b>	<b>0</b>
期末配当金	<b>10</b>	<b>10</b>
年間配当金	<b>10</b>	<b>10</b>

※2022年5月13日現在において、配当予想額は、1株当たり=10円を予定しております。

## APPENDIX

バーンイン（ボード）	バーンインは、半導体の初期不良を除去する選別方法の1種。バーンインボードは、通常の使用環境であれば2～3年以内で故障するおそれのある半導体を取り除くテスト工程（パッケージバーンインテスト）で用いられる基板。半導体製品の動作を検証、初期不良品を選別。
LSI	大規模集積回路。ICのうち、素子の集積度が1,000個～10万個程度のものを「MSI」（Medium Scale Integration）、1万ゲート位までのものを「LSI」と呼ぶ。これ以上はVLSI（Very Large Scale Integrated Circuit）と呼ばれている。
IC	半導体集積回路。トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの素子を集めて基板の上に装着し、各種の機能を持たせた電子回路。（Integrated Circuit）
I/F回路（アイエフ回路）	受信機・通信機において周波数変換された信号を処理する電子回路。
FPGA	プログラムすることができる論理LSI。マイクロプロセッサやASIC（特定用途のために設計されたIC）の設計図を送り込んでシミュレーションすることが可能。（Field Programmable Gate Array）
ASIC	特定の用途のために設計されたIC。フルカスタムICは注文に応じてゼロから設計、セミカスタムICはあらかじめ特定の機能を持った回路ブロックを組み合わせた「半完成品」をもとに、配線を変えることで要求に合わせたもの。（Application Specific Integrated Circuit）
JPEG	静止画像データの圧縮方式の一つ。圧縮の際に若干の画像劣化を許容する（劣化許容レベルの指定あり可能）方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことが可能、現在のデジタルカメラのほとんどは、記録画像のファイル形式にJPEGを使用。（Joint Photographic Experts Group）
IP	再利用可能な設計資産（知的財産）。ICの設計と製造の分業化により、IPが独自の市場を形成。（Intellectual Property）
MIPI	企業団体MIPI Alliance(本部米国：ノキア、テキサス・インスツルメンツ等により設立)が策定する、モバイル機器のカメラやディスプレイとのインターフェイス規格。（Mobile Industry Processor Interface）
CMOS	半導体の一方式であるMOS（半導体の中で動いている自由電子か、自由電子が飛び出した後の正孔のいずれかによって電荷が運搬されるトランジスタ）を改良したもので、電荷の運搬に自由電子と正孔の両方を用いるため、MOSに比べて動作速度が高い特徴がある。（Complementary Metal Oxide Semiconductor）
PLC	電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行う技術。通信専用線を新たに追加敷設が難しい場所や、無線通信が困難な状況下で、既存の電力線（照明用やコンセント用等）にデータをのせて通信するもの。（Power Line Communication）
ISP	カメラの中に入っている機能であり、画像の信号を処理する機能。（Image Signal Processor）

## ご清聴ありがとうございました

本資料および決算説明会で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは大きく異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

### ご注意事項

#### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

### お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/